

第 47 回 UV/EB 表面加工入門講座(大阪)

期 日：2019 年 11 月 11 日（月）9：30～17：30

会 場：関西大学 千里山キャンパス 第四学舎 3 号館 3401 号室

主 催：一般社団法人ラドテック研究会

協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会
一般社団法人日本接着学会・合成樹脂工業協会
一般社団法人日本塗装技術協会
一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会
フォトポリマー懇話会・日本放射線化学会（予定）

<プログラム>

- 1) 9：30～10：30 「UV 硬化技術総論」
大阪府立大学大学院 白井 正充
- 2) 10：30～11：30 「UV/EB モノマーおよびオリゴマーの設計」
荒川化学工業株式会社 平崎 正和
- 11：30～11：50 <名刺交換>
11：50～12：40 <昼食>
- 3) 12：40～13：40 「光重合開始剤の種類と特性」
BASF ジャパン株式会社 鮫島かおり
- 4) 13：40～14：40 「UV 光源と照射プロセス」
ヘレウス株式会社 河村紀代子
- 14：40～15：00 <名刺交換>
15：00～15：10 <休憩>
- 5) 15：10～16：10 「電子線の基礎と工業利用の現状」
株式会社 NHV コーポレーション 岡崎 泰三
- 6) 16：10～17：10 「紫外線硬化樹脂の硬化過程の測定法」
金沢大学 瀧 健太郎
- 17：10～17：30 <名刺交換>

※講演タイトルは変更になる場合がございます。

1. 参加費 個人会員（本人）無料
法人会員（2名まで）無料 3名から1名10,000円（消費税含）
非会員は1名20,000円（消費税含）
協賛団体に所属されている方は下記の通りとなります。
- 協賛団体所属の方：10,000円（消費税含）
注・上記参加費には、講演要旨集1冊を含みます。
2. 申込締切日 2019年11月6日（水）
3. 申込方法 添付申込書に必要事項をご記入後E-mailにてお申し込み下さい。
4. 入金方法 参加費は銀行振込にてお願い致します。
（尚、振込手数料はご負担下さい。）
振込先： みずほ銀行 麹町支店
（銀行コード：0001 店番号：021）
口座番号： 普通預金）1361387
口座名義： 一般社団法人ラドテック研究会
名義カナ： シャ）ラドテックケンキュウカイ
ご入金は開催日までにお願ひ申しあげます。
※一度ご入金された参加費は返金致しかねますので、あらかじめ
ご了承下さい。
5. 参加証 ご入金確認後参加者本人宛お送り致します。
従ってお申し込み及びご送金が申込締切日以降で開催日が迫っている
場合は参加証が届かない場合がありますので、参加受付番号等を事務局
まで事前にお問い合わせ下さい。なお、領収書は振込受領書をもって
かえさせていただきます。
6. 問合せ先 一般社団法人ラドテック研究会事務局
〒102-0082 千代田区一番町23-2 番町ロイヤルコート207
TEL：03-6261-2750 FAX：03-6261-2751
E-mail：staff@radtechjapan.org

受講申込書
＜協賛団体加入者専用＞

＜ラドテック研究会事務局宛＞

E-mail: staff@radtechjapan.org

第 47 回（大阪）UV/EB 表面加工入門講座に受講申込み致します

所属先：

（会社名／大学名等）

氏 名：

住 所：〒 _____

T E L : _____ F A X : _____

E-mail : _____ @ _____

★請求書は ・ 必要です ・ 必要ありません （どちらかに○）

☆受講料は _____ 月 _____ 日
・ 振り込みました ・ する予定です（どちらかに○）

★協賛団体名： _____（ご記入ください）

振 込 先： みずほ銀行 麴町支店（銀行コード：0001 店番号：021）
口座番号： 普通預金）1361387
口座名義： 一般社団法人ラドテック研究会
名義カナ： シャ）ラドテックケンキュウカイ

（尚、振込手数料はご負担頂きたくお願い申し上げます。）